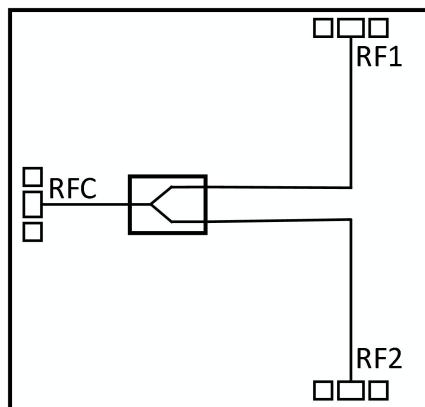




性能特点：

- 频率范围：12 ~ 18GHz
- 插入损耗： 0.3dB
- 隔离度：25dB
- 回波损耗：-15dB
- 芯片尺寸：1.4mmx1.3mm x 0.1mm



产品简介：

XPD-1218 是一款 GaAs MMIC 二功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点，广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理，适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

电参数：(TA=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率	12		18	GHz
插入损耗		0.3		dB
隔离度		25		dB
输入回波损耗		-20		dB
输出回波损耗		-25		dB

使用极限参数：

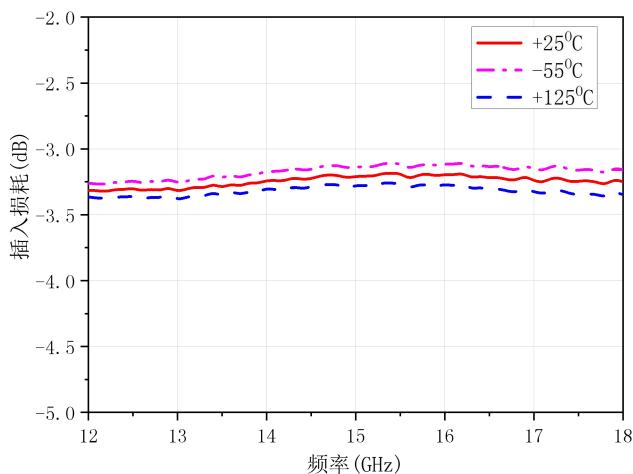
最高输入功率	+20dBm
储存温度	-65°C ~ 150°C
使用温度	-55°C ~ 125°C

注：超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。

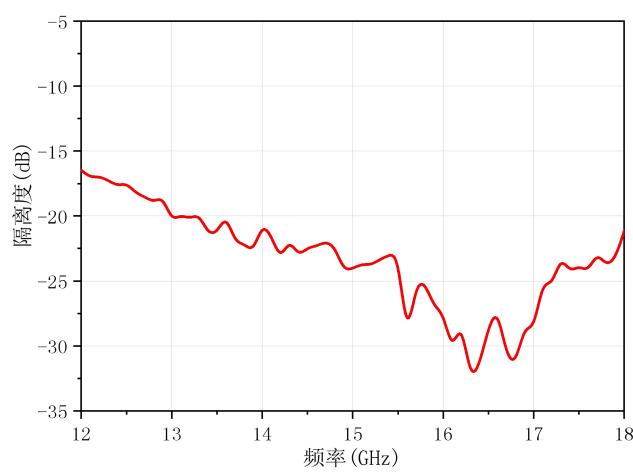


典型曲线：

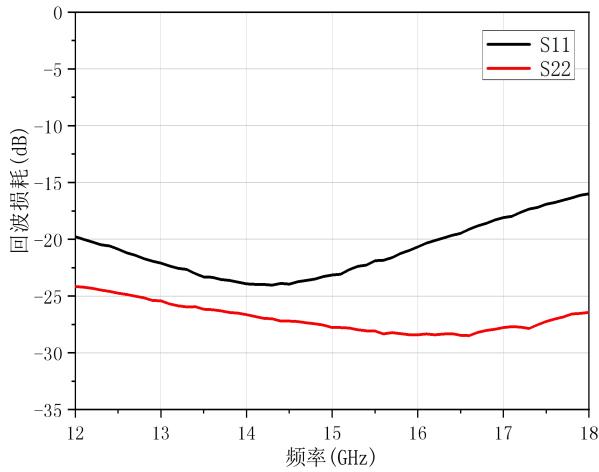
插入损耗 VS 温度



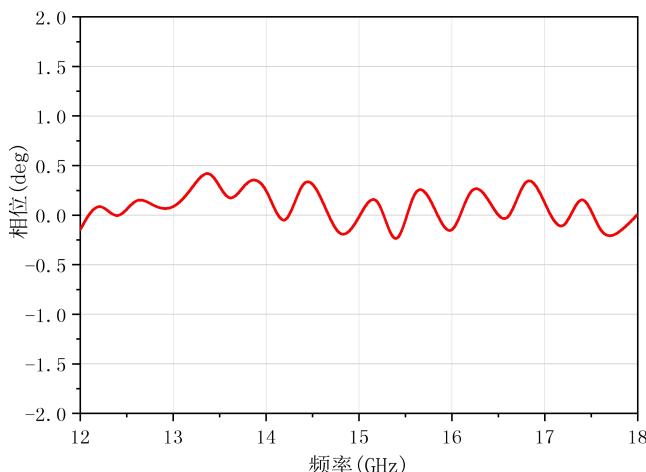
隔离度@25°C



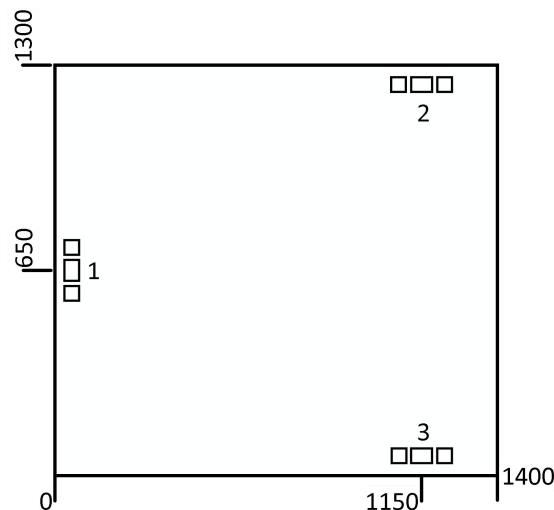
输入/输出回波损耗@25°C



相位一致性@25°C



芯片尺寸外形图：(单位 μm)



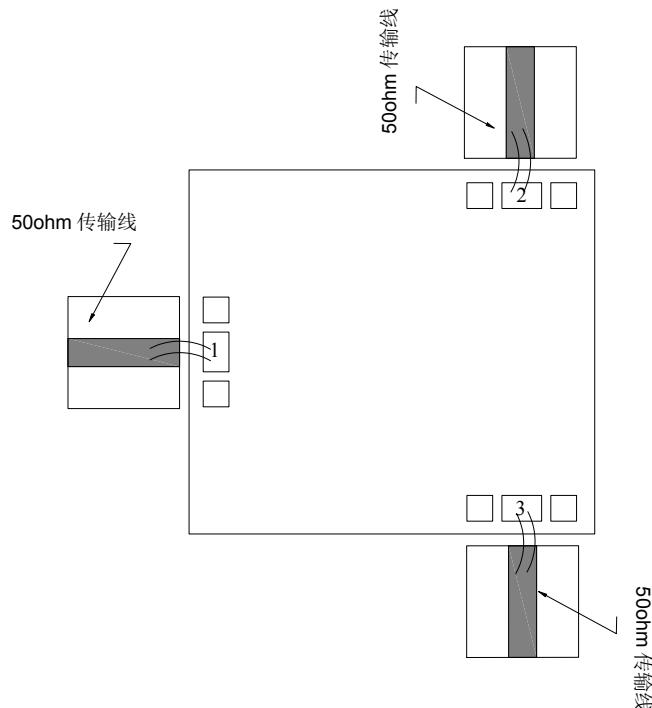
注：图中单位均为微米 (μm)；外形尺寸公差 $\pm 50\mu\text{m}$ 。



脚定义与功能：

管脚	名称	功能描述
1	RFin	RF 输入端口，阻抗 50ohm
2	RFout	RF 输出端口，阻抗 50ohm

芯片建议装配图：



使用注意事项：

- 1、芯片需要贮存在干燥洁净的 N_2 环境中；
- 2、电路为静电敏感器件，请严格遵守 ESD 防护，避免裸芯片静电损坏；
- 3、使用时，芯片务必保证接地良好；
- 4、建议使用直径 $25\mu m$ 的金丝键合；
- 5、电源供电禁止反接，以免使得器件永久损坏。